



華立 4 月份營收達 65.5 億 創歷史同期最高記錄

2024.05.10 高科技材料設備供應商華立，2024 年 04 月自結合併營收 65.5 億元、年增 29.1%、月增 15.1%，累計營收 238.0 億、年增 22.4%，綜觀 2024 年全球科技電子產業，庫存調整已接近尾聲，終端應用產品出貨恢復正成長，華立半導體先進製程及先進封裝的關鍵耗材、5G 高頻銅箔基板及 IC 載板製程用高解析度乾膜、3C 與車用高機能工程塑膠出貨動能優於預期，營收繳出雙位數的成長佳績。

AI 需求大爆發，主力客戶先進封裝 CoWoS 產能供不應求，預計在今年擴充兩倍的 CoWoS 產能，但仍無法滿足 AI 客戶的半導體需求，未來在 CoWoS 產能逐步開出下，華立封裝材料的營收將逐季攀升。大客戶從年初以來對半導體的市況樂觀積極投片，推升我們在先進製程相關產品的使用量，不論是光阻液、研磨液及溼式化學品的業績表現都高於預期。根據最新的研究機構預估，2024 年台灣晶圓代工產值將成長 15%，展望半導體產業在終端應用 AI、HPC、手機、物聯網等長期需求支撐下，華立半導體營收成長可期。

隨著半導體製程工序愈加複雜及製程節點不斷縮小，電子級氣體的純度將決定晶片製造的良率，而且在半導體製程材料成本中氣體位居第二位，但台灣目前在半導體特殊氣體的自製率卻僅有低個位數，建立氣體的本土供應鏈刻不容緩。華立看好電子級氣體未來的發展，除佈局特殊氣體的銷售多年，也將跨入大宗氣體的分裝與銷售業務，並在屏南產業園區打造全台首座氖氣提純工廠，第四季即能進入試量產階段，在 AI 風潮及半導體擴產的帶動下，氣體業績將持續正向成長。

華立引進銷售的 IC 載板高解析度乾膜受惠於 AI、高速運算、汽車及伺服器的晶片訂單業績穩中透堅，加上今年以來比特幣大幅上漲，客戶接到虛擬貨幣 ASIC 晶片的急單，也為乾膜的營收增添動力。在網路通訊年代，低軌衛星的發展符合高覆蓋率、高頻寬率的應用特性，華立的高解析度乾膜順勢切入低軌道衛星的基地台訊號接收板，客戶端已接獲全球知名低軌衛星龍頭大量訂單，第二季對乾膜的需求量將明顯上升，未來發展到 6G 時代，低軌衛星的建置數量可望取代地面上的基地台，將助攻乾膜的業績更上一層樓。



關於華立企業：本公司成立於 1968 年，配合我國工業發展與整體企業營運需求，先後引進複合材料、資訊/通訊、印刷電路板、半導體、平面顯示器、以及綠能光電產業材料與設備，以致力成為大中華地區提供高科技材料、設備與技術的全方位科技服務廠商。華立企業總公司位於高雄，先後於中國大陸、東南亞、東北亞等重要城市設立銷售據點。

新聞聯絡人：

呂淑甄

投資人關係

華立企業股份有限公司

Tel. +886-7-2164311, ext. 27093

Email : jessica@wahlee.com

Website : www.wahlee.com